

UF 158HA 底部填充胶 产品数据表

卓越的耐热循环性能
100% 兼容助焊剂残留
可承受 5 次 260 °C 回流焊

简介

UF 158HA 是一种高填料、高纯度的液态环氧底部填充材料，可流入极窄的间隙。该产品与所有免清洗焊膏助焊剂残留完全兼容，在 $5 \times 260^\circ\text{C}$ 回流焊条件下不发生焊点变形，其整体性能优于需要清洗工艺的同类底部填充材料。UF 158HA 适用于 BGA、倒装芯片、晶圆级芯片尺寸封装等应用，并可用于存储卡、芯片载体、混合电路、多芯片模块等多种先进封装中的裸芯片保护。

使用 **UF 158HA** 的主要优势：

与所有免清洗焊膏助焊剂残留完全兼容，免除清洗工艺及其带来的环境污染，显著降低制造成本，通过 $5 \times 260^\circ\text{C}$ 回流焊，焊点无任何变形，性能优于采用清洗工艺的同类底部填充材料，可流入 $20\ \mu\text{m}$ 的微小间隙，无树脂渗出

物理特性

产品名称	UF 158HA 液態封裝劑
外观	黑色
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	1.8 g/cc
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	15 – 25 kc
固化材料特性	
Tg (ASTM D3418-82)	200 °C, 245 °C
C.T. E (ASTM E 831), PPM/°C	$\alpha_1 = 20$; $\alpha_2 = 71$
剪切强度 (FR4 / FR4)	3600 psi

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm
表面绝缘电阻(J-STD-004)	通过 (Pass)

推荐固化条件

在 150 °C 条件下固化 1 小时。可根据客户需求, 提供并评估其他替代固化曲线。

储存与保质期

在 -40 °C 条件下, 若材料存放于密封的原始包装容器中, 保质期为 6 个月。超过该期限存放, 产品粘度可能会升高。储存时应避免 水分侵入、挥发及异物污染。挥发和污染可能会对产品的加工性能产生不利影响。

安全

UF 158HA 为环境友好、无毒材料。在操作和使用过程中, 仍建议遵循常规的工业卫生操作规范。有关更详细的安全信息, 请参阅本产品的 SDS(安全数据表)。

包装

UF 158HA 毛细管底部填充系列产品有售 10 cc 和 30 cc。亦可根据客户需求提供其他包装形式。订购及相关信息请联系 YINCAE。